****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **读者查询:** |  **媒体联系:** |  |
| **德国康佳特科技** | **德国康佳特科技** |
| Nick Lin 林忠义 | Crysta Lee 李佳纯 |
| 电话: +86-21-60255862 | 电话: +86-21-60255862x8931 |
| sales-asia@congatec.comwww.congatec.cn  | crysta.lee@congatec.comwww.congatec.cn |



*Text and photograph available at:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**New Product Introduction**

康佳特COM Express 计算机模块 基于最新第八代英特尔® 至强®和英特尔® 酷睿™处理器 (Coffee Lake H)

 **强大的康佳特six-pack Type6**

**Shanghai, China, 24 April 2018** **\* \* \*** 提供标准和定制化嵌入式计算机板卡与模块的领先供应商—德国康佳特科技，于4月3号推出全新conga-TS370 COM Express Type6 计算机模块，搭载英特尔同时间推出的第八代嵌入式英特尔®至强® 和英特尔®酷睿™ 处理器 (代号: Coffee Lake H)。该全新处理器将COM Express Type6模块的35-45瓦TDP层级提升至高端嵌入式计算机新的 “six-pack” 层级，首次提供最高6核，12线程和令人 印象深刻的涡轮增压(最高4.4 GHz)，并且驱动多达3个独立4K超高清显示器。康佳特的初步测试表明，与第七代英特尔®酷睿™处理器相比，这些全新6核模块的多线程性能提高了45%到50%，单线程性能提高了15%到25%。在给定的TDP下，系统设计在整体功耗较低的情况下实现更高的带宽，最终实现更高的系统效率。目标应用为高性能嵌入式和移动系统，工业和医疗工作站，存储服务器和云工作站，以及媒体转码和边缘计算内核。

“ 医疗成像和工业4.0市场应用以及视频分析(如: 态势感知交通观察) 都非常需要各方面的性能进步，” 康佳特产品管理总监 Martin Danzer 说明到。 “ 我们致力于简化性能提升的使用，透过我们标准化的计算机模块，散热解决方案和eAPIs，使升级至最新处理器几乎成为即插即用任务。”

除了性能提升，全新康佳特模块还支持超过10年的长期供货，高带宽I/O接口4个USB3.1Gen.2 (10 Gbit/s)和英特尔® 傲腾™ 存储支持，以及增强的安全性能，包括英特尔® Software Guard Extensions和 英特尔® 可信执行技术(英特尔® TXT)。

**详细功能特色**

全新conga-TS370 COM Express Basic Type6 计算机模块可支持6核英特尔® 至强® 和英特尔® 酷睿™ i7处理器，或4核英特尔® 酷睿™ i5处理器，采用35到45 W cTDP封装以及最高32 GB DDR4 2666内存( 可选ECC)。集成的英特尔® UHD630图形显卡可通过DP1.4, HDMI, eDP和LVDS来支持高达3个独立4K显示器(最高可达60Hz)。设计人员首次可以单纯通过软件从eDP切换到LVDS，无需修改任何硬件。该模块提供杰出的高带宽I/O, 包括4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), 8x USB 2.0 和 1x PEG 以及8 PCIe Gen 3.0 通道，可用于强大的系统扩展，包括英特尔® 傲腾™ 存储。可执行所有Linux 操作系统以及64位微软Win10和Win10 IoT 版本。该全新模块的服务支持包含优质的技术集成支持与广泛的配件以及标准或定制的载板与系统。

全新conga-TS370 COM Express Type6计算机模块提供以下标准备置:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores/Threads** |  | **Clock [GHz] (Base/Boost)**  |  | **Cache (MB)**  |  | **TDP / cTDP [W]**  |
| Intel® Xeon® E-2176M |  | 6 / 12 |  | 2.7 / 4.4 |  | 12 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i7-8850H |  | 6 / 12 |  | 2.6 / 4.3 |  | 9 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i5-8400H |  | 4 / 8 |  | 2.5 / 4.2 |  | 8 |  | 45 / 35 |

更多conga-TS370 高性能 COM Express Type 6 计算机模块详情: <http://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-ts370.html>

**关于德国康佳特**

德国康佳特科技,为嵌入式计算机模块COMExpress,Qseven和SMARC的领导供应商，且提供单板计算机及定制设计服务。康佳特产品可广泛使用于工业及应用，例如工业化控制，医疗科技，车载，航天电子及运输…等。公司的核心及关键技术包含了独特并丰富的BIOS功能，全面的驱动程序及板卡的软件支持套件。用户在他们终端产品设计过程，通过康佳特延展的产品生命周期管理及现代质量标准获得支持。自2004年12月成立以来, 康佳特已成为全球认可和值得信赖的嵌入式计算机模块解决方案的专家和合作伙伴。目前康佳特在美国，台湾，日本，澳大利亚，捷克和中国设有分公司。更多信息请上我们官方网站[www.congatec.cn](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cschmid%5C%5CAppData%5C%5CUsers%5C%5Cbeckylin%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CUsers%5C%5Cbeckylin%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CTemp%5C%5Cnotes5CC417%5C%5Cwww.congatec.cn)关注康佳特官方微信: congatec, 关注康佳特官方微博[＠康佳特科技](https://www.weibo.com/congatec)

\* \* \*

*Intel and Intel Core, Xeon, and Optane are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*